



参加無料



『同志社大学×コマツ株式会社』

—企業の未来を変えた産学連携とは—

作りたい製品があっても、ノウハウがなく諦めてしまっていないですか？
その壁を壊せる手段のひとつに「産学連携」があります。

本セミナーでは、東大阪市の中小企業が製品開発のため大学の研究者と連携し、
AIを活用して建築業界の常識を覆す製品を開発した事例を紹介します。

セミナー後半には、MOBIO初のトークセッション形式で、
2者に登壇いただき生の声をお届けします！

産学連携に興味はあるが、「連携するきっかけをどう得るのか」や
「連携してからの具体的な進め方がわからない」方におすすめのセミナーです。

トークセッションで語られる臨場感あるエピソードを聞いて、
産学連携についての理解を深めましょう！

開催日時

2026年 1月27日(火) 15:00～17:00

開催場所

MOBIO産学連携オフィス セミナールーム
(クリエイション・コア東大阪 南館2F)

申込締切日

2026年 1月26日(月)

登壇者



同志社大学 理工学部
インテリジェント情報工学科
教授

奥田 正浩 (おくだ まさひろ) 氏



コマツ株式会社 代表取締役

小松 智 (こまつ さとし) 氏

申込方法

QRコードよりお申込みください。



主催：MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）、同志社大学

※お申込みいただきました情報は、主催者であるMOBIOおよび同志社大学で共有いたします。

お問い合わせ先：MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）

〒577-0011大阪府東大阪市荒本北1-4-17 クリエイション・コア東大阪北館1F

【担当】川根【TEL】06-6748-1011【E-mail】mobio_innovation@obda.or.jp

【受付時間】月～金 9:00～17:00（祝日・年末年始除く）

※セミナーにご参加の際は、公共交通機関をご利用ください。

